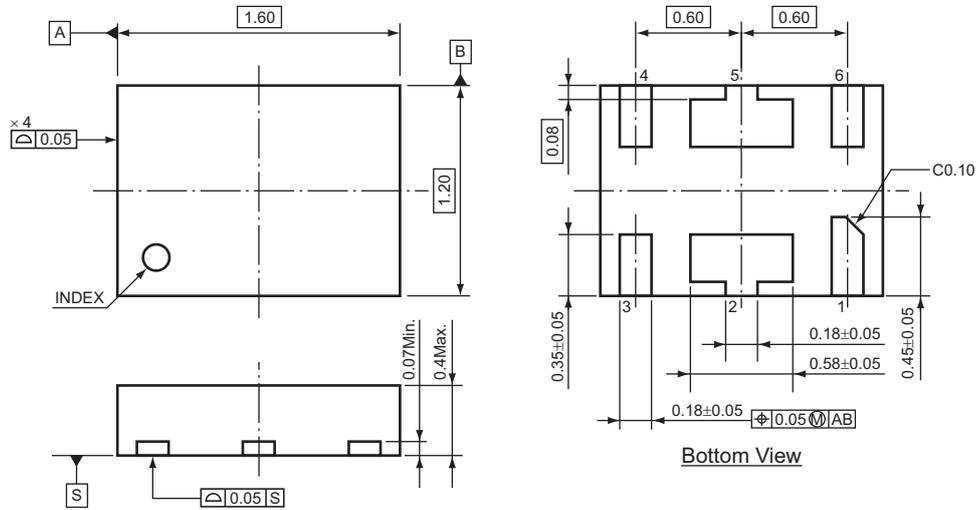


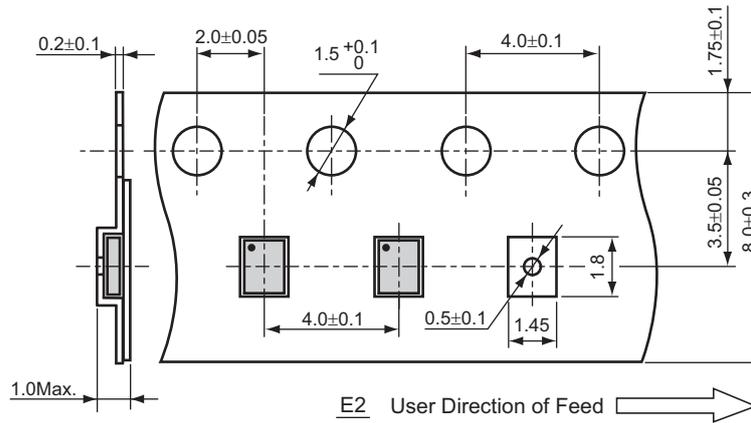
DFN(PLP)1216-6G

(単位 : mm)

■ パッケージ外形図

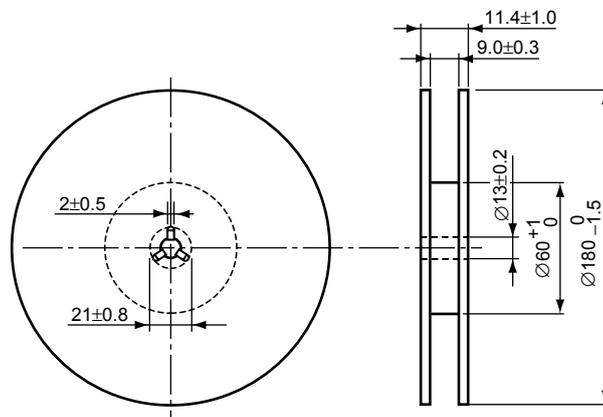


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=5,000 個)



■ 許容損失について (DFN(PLP)1216-6G)

DFN(PLP)1216-6Gパッケージの許容損失について特性例を示します。

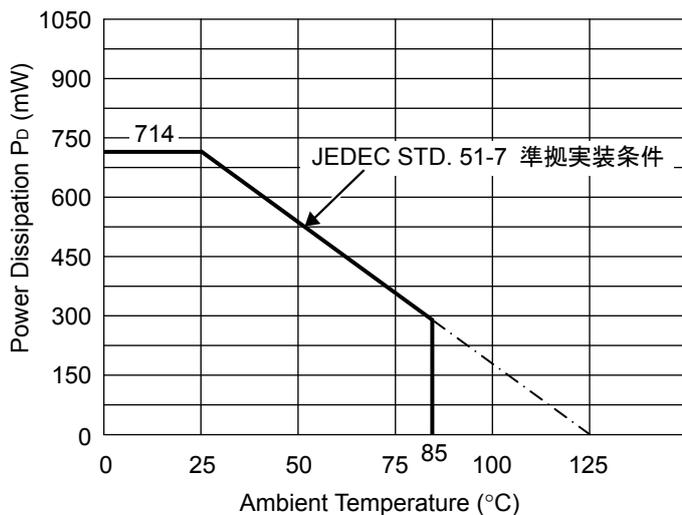
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

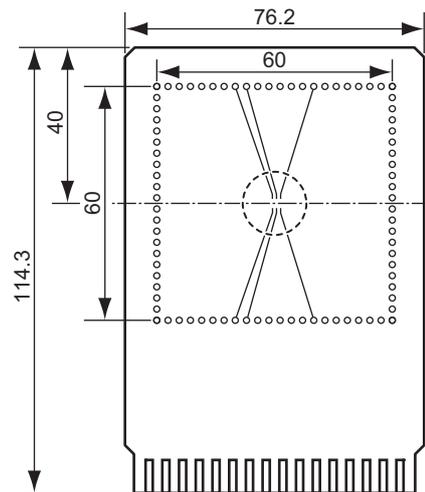
	JEDEC STD. 51-7 準拠実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	76.2mm×114.3mm×1.6mm
配線率	表裏層:60mm角 :配線率 10%以下 内層 :74.2mm角 :配線率 100%
スルーホール	直径 0.85mm×44 個

測定結果 (Ta=25°C, Tjmax=125°C)

	JEDEC STD. 51-7 準拠実装条件
許容損失	714mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.714\text{W} = 140^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 21^\circ\text{C/W}$



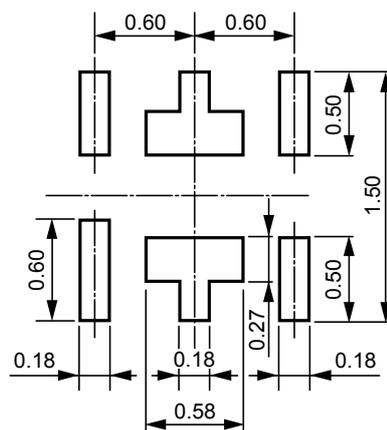
許容損失特性



基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

■ 基板パッド推奨寸法



(単位 : mm)